

半导体搬运自动化解决方案半导体设备展会、2024年国际半导体设备及材料展会

产品名称	半导体搬运自动化解决方案半导体设备展会、2024年国际半导体设备及材料展会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日 展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

作为中国重要的半导体设备展会之一，SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会将吸引来自全球的半导体设备制造商和供应商参展，展示新的半导体技术和设备。本文将详细介绍该展会的亮点，帮助读者更好地了解 and 期待此次盛会。

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会将于2024年6月26日至28日在深圳会展中心举行。旨在展示新的半导体技术和设备，推动中国半导体产业的发展。除此之外，展会同期将结合行业热点推出主题活动40+，邀请近百位行业院士、企业代表、业界大咖专题演讲行业前沿科技与思维，加速科研成果转换应用落地，全方位多角度推动中国半导体产业高质量发展。

第六届深圳国际半导体展将在深圳国际会展中心4号馆、6号馆和8号馆举行，3馆联动，10+细分展品类别，抢跑新兴产业机遇。本届展会将汇聚芯片设计、晶圆制造与封装、先进材料、Mini/Micro-LED、电源&储能技术、半导体专用设备&零部件、IC载板/陶瓷基板、电子元器件、第三代半导体、AI与算力、算法、存储、CPO共封装、qiche半导体/车规级先进封装技术、机器视觉与传感器、毫米波雷达、激光雷达/自动驾驶、微电子综合智造等领域，联动产业链上下游，实现一站式解决资源互通、信息交流、产品贸易的需求，成就不容错过的行业盛会。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、

封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等qiche雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、qiche半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、qiche电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

展会特点

1.国际化程度高：此次展会将有来自全球的半导体设备制造商和供应商参展，国际化程度高，将覆盖美国、欧洲、日本等国家和地区的企业。

2.展示新的技术和设备：此次展会将展示新的半导体技术和设备，包括制造设备、封装设备、测试设备等，以及相关的材料和配件。

3.性强：此次展会的观众群体主要是半导体行业的人士，包括制造商、供应商、科研机构等，性强，能够更好地交流和洽谈。

4.活动丰富：此次展会期间将举办一系列丰富多彩的活动，包括技术论坛、产品发布会、人才交流会等，为观众提供更多的信息和机会。

展会亮点

1.中国的半导体设备企业将悉数亮相

2.全球的半导体设备制造商和供应商将参展：此次展会将有来自全球的半导体设备制造商和供应商参展，将展示新的技术和设备，为观众带来前沿的科技体验。

3.论坛和技术研讨会：此次展会期间将举办一系列论坛和技术研讨会，邀请和学者就半导体技术的发展趋势、市场前景等进行深入探讨，为观众提供更多的信息和启示。

4.人才交流会：此次展会期间还将举办人才交流会，为参展企业和人才提供一个交流和对接的平台，促进人才流动和企业招聘。